



2007年12月3日
芝浦メカトロニクス株式会社

RFID・高周波デバイス用超高速フリップチップボンダ 「TFC-5500」を発表

芝浦メカトロニクス株式会社（社長：森田 茂樹、横浜市栄区笠間2-5-1）は、RFIDや高周波デバイスに最適な超高速フリップチップボンダを開発し、2007年12月より受注を開始いたします。

本装置は、12月5日から開催されるSEMICON Japan 2007に実機出展します。

1. 開発の背景

半導体パッケージ市場は、LED・RFID・MEMSなどの新しいパッケージ需要の拡大が期待されています。そのパッケージの量産化を実現する生産性の高い装置が要求されています。

当社では、そのニーズに応えるため、高生産性・省スペースを実現するフリップチップボンダ「TFC-5500シリーズ」を開発しました。

2. 装置の特長

1) 高速・高生産性

生産サイクルタイム：0.7秒/IC（プロセス時間0.3秒含む）。

1枚のウェーハから供給されたダイを、2対のボンディングヘッドを使用することで、従来機比約2倍の業界最高速レベルの生産性を実現。

2) 高信頼性

低温/短時間で実装可能な超音波接合プロセスを採用し、高い接合信頼性を実現。

3) 2種類の基板形状に対応

『短冊形状基板のキャリアタイプ』、『テープ形状基板のリール to リール』の2種類の基板搬送機構を選択可能。

4) 適用ダイサイズ； 0.4mm～ 3.0mm

芝浦メカトロニクス株式会社



3. 今後の展開

今後、半導体の新パッケージ市場の拡大に対応して、新技術・新商品を開発していきます。

4. 装置外観写真



以上

本件お問い合わせ先 : 芝浦メカトロニクス(株) 広報室 葛城 誠一

TEL 045-897-2425

FAX 045-897-2470